

华虹半导体有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“华虹公司”或“华虹半导体”）为贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理，大力提高上市公司质量，助力信心提振和资本市场稳定发展的精神，特制定《华虹半导体有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

一、专注晶圆代工主营业务，优化运营效率，提升核心竞争力

华虹半导体是全球领先，也是中国大陆最大的特色工艺晶圆代工企业。立足于先进“特色 IC+功率器件”的战略目标，公司聚焦五大特色工艺平台，持续为客户提供满足丰富市场需求的特色工艺技术和晶圆代工服务。根据全球纯晶圆代工企业最新公布的 2024 年销售额情况，华虹公司位居全球第五位，中国大陆企业第二位。二十多年来，公司依靠卓越的特色工艺技术实力、可靠的产品性能品质与稳定的产能供给能力，赢得了全球客户的广泛认可。

1、提升工艺水平，丰富产品组合，开拓新的应用领域

过去数个季度，全球半导体市场及晶圆代工行业都经历了一定程

度的低迷和震荡。2023 年，终端需求疲软、下游库存高压的情况在 2024 年迎来一定的复苏，但仍呈现分化。一方面，以 AI 及消费电子为代表的领域需求快速改善并带动相关晶圆代工平台稳步增长；另一方面，工业、新能源等领域需求复苏仍比较疲软，叠加同行业产能的大量释放，导致价格承压。除台积电外，行业领先企业也都出现了经营业绩、产能利用率不同程度的下滑。2024 年，公司经营业绩同样面临压力，全年营业收入下滑约 12.3%，至 20.04 亿美元¹。但在管理层及公司全体员工的共同努力下，业绩呈逐季改善的趋势，在公司 12 英寸产能爬坡和产品导入的挑战下，仍保持了年平均产能利用率接近满载，较同行业处于领先水平，这也展现了作为中国大陆特色工艺领域的领军企业，公司的业务发展仍然具有相当的韧性，为未来收入和业绩的不断改善打下基础。

公司深知半导体与晶圆代工行业的运行规律，在行业下行周期中亦是低端产能出清、竞争格局变化调整的关键时期，优秀公司经过调整在未来会展现出更强的竞争活力和业绩增长。全球半导体市场在 2025 年预计将逐步筑底回升，其中，AI 周边应用及消费电子领域的芯片需求预计仍将快速增长，同时，原本具有丰富应用场景的汽车电子及工业控制等领域预计也可能展现结构性的复苏态势。

公司利用自身在特色工艺领域工艺平台覆盖全面、工艺技术积累深厚、客户储备多元等优势基础，聚焦重点工艺平台的研发迭代和工艺突破，保障产品组合不断丰富以满足快速变化的下游应用需求，积

¹ 根据公司港股《2024 年年度报告》数据

极主动进行行业趋势及下游市场应用需求的研究判断，跳出晶圆代工企业与设计公司的传统合作模式，拓展产业链生态建设，不断发掘特色工艺在消费电子、汽车电子、新能源及其他新兴领域的创新需求。从而巩固自身在特色工艺代工领域的优势，发挥出作为中国集成电路晶圆代工行业领军企业的核心地位与引导作用。

工艺平台	芯片类型	技术特点	重要应用场景		
嵌入式非易失性存储器	车规、工控、消费类等 MCU；智能卡芯片；	存储性能更强、综合功耗更低、稳定性更好以适应丰富的各类应用场景			汽车智能化、工控、消费、物联网各类 SIM 卡等
独立式非易失性存储器	NOR Flash、EEPROM 等				
功率器件	MOSFET、超级结、IGBT	中高压器件功率密度更大、可靠性更高，适应各类高压、大电流场景			消费类快充、服务器电源、新能源、光伏等
模拟与电源管理	信号链类及电源管理类模拟芯片	涵盖中低压至高压、超高压的各类工艺平台以适应不断迭代的应用需求			服务器、工控、汽车电子、消费等领域
逻辑与射频	射频芯片、图像传感器及特色逻辑芯片	丰富的特色逻辑射频工艺平台满足各类型应用方案			WIFI、蓝牙、消费电子摄像投等

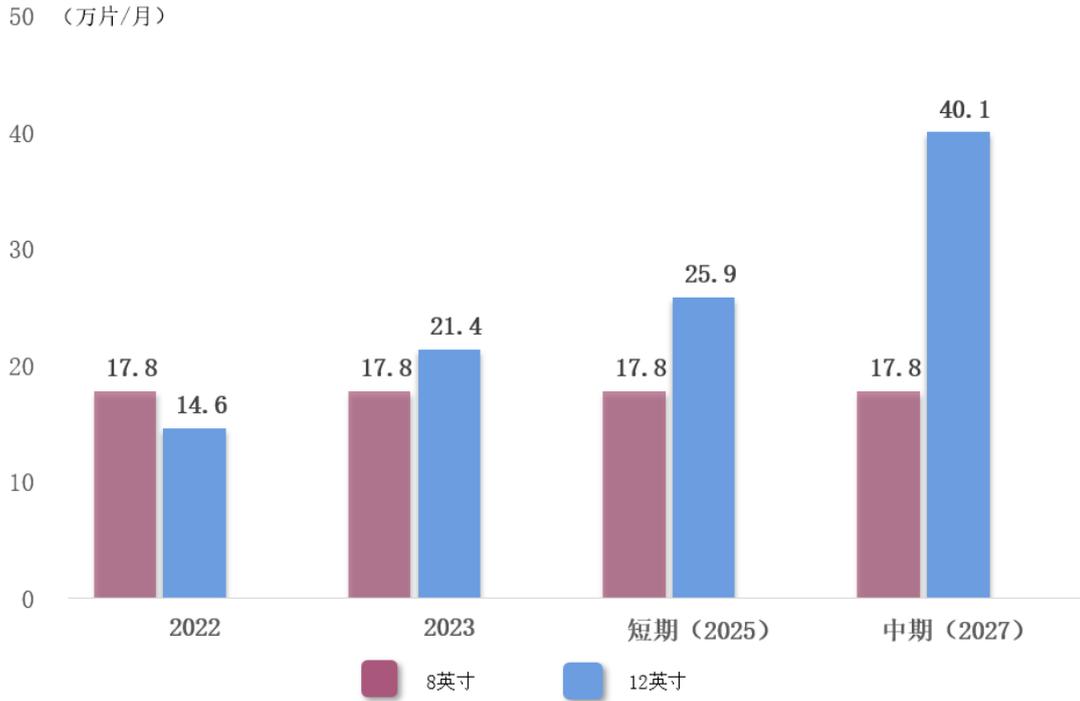
表：公司 5 大特色工艺平台主要产品类型、应用场景及图示

2、坚持“8 英寸+12 英寸”发展战略，快速推进新产线的产能爬坡

“8 英寸+12 英寸”一直是华虹半导体发展特色工艺晶圆代工工业

务的核心战略，未来公司亦将坚定不移地持续推进。2023-2024 年，公司先后完成第一条十二英寸产线——华虹无锡 9.5 万片/月的产能扩产计划，技术平台、产品组合进一步丰富；以及无锡新十二英寸产线——华虹制造的建设、设备搬入及顺利投产，标志着核心战略达成重要阶段性成果，预计于 2025 年起贡献销售收入。

华虹制造项目作为公司发展战略的全新阶段，将导入包括 40nm 工艺节点在内的各工艺平台的新一代工艺技术，包括全新的低功耗嵌入式及独立式非易失性存储器工艺、对标国际领先水平的新一代 IGBT 及超级结 MOSFET 工艺、“BCD+”工艺组合及新一代特色逻辑与射频特色工艺技术等。新技术和新工艺的导入将会带来全新的挑战与机遇，但公司将一如既往地展现“华虹速度”，依托成熟而富有经验的管理层、自身强大的研发能力和高效的运营效率，公司将预计顺利、快速的完成华虹制造产线的验证与爬坡，为“8 英寸+12 英寸”战略的两翼齐飞增添新的助力。

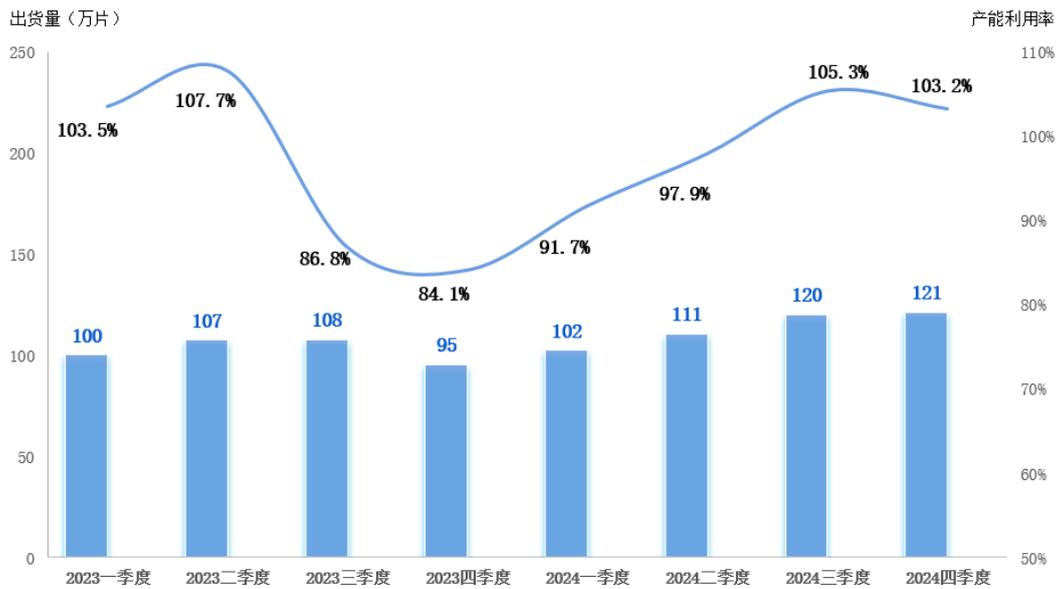


图：公司 8 英寸及 12 英寸产能规划情况²

3、维持高效产能利用率，优化运营效率

伴随着需求疲软，全球主要晶圆代工企业的产能利用率自 2022 年下半年以来均出现一定的波动，部分企业产能利用率下滑情况较严重。华虹半导体作为一家拥有丰富工艺节点和工艺平台覆盖的领先特色工艺企业，充分利用了自身柔性产能和高效管理的优势，在行业下行的过程中未出现产能利用率的大幅波动并整体维持在较高的水平，2024 年度公司平均产能利用率为 99.5%，这在全球晶圆代工企业中已相当出色。

² 12 英寸产能为约当 8 英寸数据



图：公司 2023 年一季度以来晶圆出货量及产能利用率情况

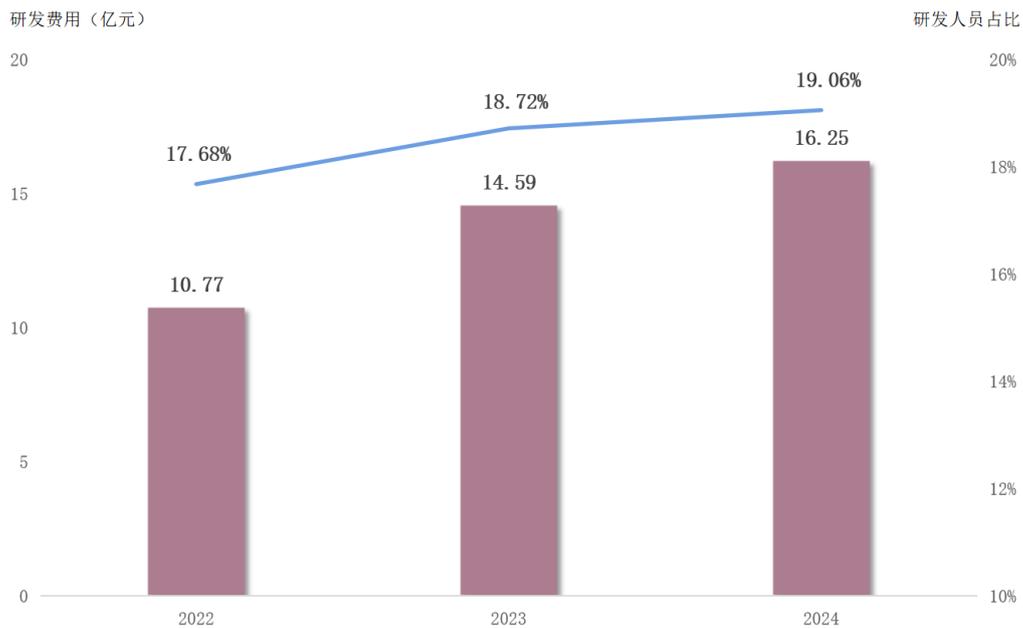
此外，面对行业筑底周期所带来的盈利能力承压，公司自 2024 年起已展开一系列降本增效行动，管理层架构的调整带来了全新的管理营运经验，公司自上而下，在采购供应链、市场销售、技术研发、生产制造、信息系统及其他后台营运等领域全面梳理优化，从制度、执行、理念全方位入手提升营运效率。

2025 年，市场需求仍将呈现结构性复苏态势，但伴随国内大量产能的释放以及公司新产线产能爬坡，新产线的营运仍充满挑战。公司会凭借自身丰富的经验，及在技术、产品、客户方面的积累，力争在投片/产出数量爬坡和产品组合验证与导入两方面都取得良好的营运成绩，顺利完成产线一阶段的各项任务目标，为未来二阶段的全面满产打下坚实基础。

4、加强研发能力，持续提升晶圆代工企业的核心竞争力，打造新质生产力

作为打造新质生产力的核心要素，工艺水平一直以来都是晶圆代工企业的核心竞争力，华虹半导体亦在提升自身研发能力和工艺水平的道路上不断前行。2022-2024 年，公司研发人员数量占公司总员工数比例分别为 17.68%、18.72%及 19.06%；研发投入金额分别为 10.77 亿、14.59 亿及 16.25 元³，均保持持续上升的态势。截至 2024 年 12 月底，公司累计获国内外授权专利达 4,644 项。2025 年，公司仍将着重建设公司的研发人员队伍和研发体系，包括：一、持续加大研发投入，重点突破核心工艺平台的全新工艺能力，积极探索及打造各工艺平台的新一代特色工艺技术，预计 2025 年研发人员占比水平及研发投入金额都保持不低于 2024 年的水平，专利申请及获授权数量也将继续保持增长；二、加强研发合作机制探索，与高校、科研机构、企业开展合作，共同进行新工艺技术和产品的打造与开发；三、完善技术创新激励机制，鼓励员工积极参与创新活动，调动其积极性与主动性，并提供相应的体系化支持。

³ 政府补助抵减后的研发费用



图：公司 2022-2024 年研发费用及研发人员占比情况

凭借公司强大的研发能力及雄厚的工艺水平，华虹半导体可以进一步发挥晶圆代工企业在中国大陆半导体产业链中的核心优势，助力产业及区域新质生产力的加快成型。

二、提升公司治理及信息披露水平，打造华虹公司在资本市场的品牌声誉

1、提升公司治理结构和规范运作能力

2023 年 8 月，华虹公司登陆上海证券交易所科创板，成为一家沪港两地上市公司，这对公司的公司治理结构和内部规范运作提出了更高的要求。公司在满足两地上市相关规则、章程等基本要求的基础上，结合公司实际情况，制定了持续提升公司治理、完善内部控制管

理体系的方案，包含内部汇报及决策流程、客户及供应商风险反馈管理、强化员工培训、提升员工权益保护以及产品安全保障及质量管理等各个方面，并定期开展风险评估、内部审计等监督措施，以确保公司的持续稳健、合规经营。

作为一家于中国香港注册成立并于上交所科创板、香港联交所两地上市的企业，公司会面对相对复杂的监管与法律环境，公司将建立监管动态跟踪反馈机制，定期收集、分析两地资本市场最新监管政策及法律法规，适时传递给主要股东、董事、管理层及相关业务部门。同时，公司也将积极响应监管精神，完善各层级公司的法人治理结构以及独立董事、董事会委员会的监督制度，强化控股股东社会责任意识，强化独立董事等外部人士监督机制，强化董事、高管等核心人员的合规意识，推动公司治理结构向高质量发展。

2、持续利用各类资本市场工具等措施提升股东回报

公司一直以来都非常重视投资者回报，先后于 2015-2018 年度在香港联交所进行过 4 次年度分红。科创板上市后，公司重新修订并通过了《华虹半导体有限公司之组织章程细则》，对公司利润分配的原则、形式、现金分红比例、条件以及利润分配的决策、实施程序等均进行了规定。2023 年度，作为登陆科创板后的第一年，公司在面对行业显著波动和较大资本开支需要的背景下，仍然通过了年度分红方案，向全体普通股股东派发现金分红约 2.57 亿元；同时，基于对华

虹半导体未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，公司间接控股股东上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）于 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 2 月 26 日期间累计增持公司 A 股股份 119.85 万股，公司部分高级管理人员于 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 1 月 4 日期间累计增持公司 A 股股份 5.36 万股。

2025 年，公司将继续秉承积极回报股东价值的经营理念，在遵守两地监管规则及内部规章的基础上，在保持公司合理资本开支，稳健经营发展计划的需求前提下，积极采用各类资本市场工具开展市值管理工作，展现公司价值，与股东一起分享公司发展的收益，提升广大投资者的长期获得感。

3、提高社会责任意识、持续进行社会公益事业

华虹半导体是一家极具社会责任意识，并积极开展社会公益活动的企业。公司把环境、社会及公司治理情况（ESG）管理融入产品、业务营运及企业发展的核心战略中，形成了员工责任、社会责任、民生责任、投资人责任四大维度的 ESG 管理策略。未来，公司也将继续加强 ESG 培训及 ESG 信息披露的内容。



同时，在进行定期 ESG 披露的基础上，公司也积极投身于社会公益事业。消费扶贫是国家乡村振兴长效机制建设的关键一环，自 2019 年起，公司积极参与云南省对口县市的结对帮扶，采用多元化消费模式，开展产销对接，切实解决边远农村畜产品销售渠道问题，帮助结对地区实现稳定增收。2025 年，公司亦将继续投入各类社会公益事业，传递社会责任与公司价值。

4、提升信息披露水平、丰富投资者交流方式，诚信打造华虹公司的资本市场形象

沪港两地上市对公司的信息披露水平提出了更高的要求，公司对自身信息披露及投资者关系工作提出了规范化、透明化与积极化的递进式要求。规范化方面，公司将严格遵照上海证券交易所及香港联交所两地《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和公司内部《市

值管理制度》《信息披露管理制度》等规定，加强内部培训机制并做好监管机构、股东、董事及高管等的高效沟通，严谨、合规、及时、高质量地开展信息披露工作。透明化方面，公司将高度重视投资者获取公司信息的平等性，确保所有投资者拥有平等获取公司最新信息的方式，建立体系化的信息披露渠道，通过投资者关系邮箱、投资者沟通热线、公司官网、媒体平台、业绩说明会等多维度进行信息发布，满足广大中小投资者的问题需求并将更多值得分享的公司经营信息进行快速发布。积极化方面，公司希望未来的信息披露工作将规范化、透明化的基础上，以市值管理和提升公司价值为目标，积极地、更高频次地向资本市场和社会大众传递公司价值和经营理念，建立与华虹公司的行业地位、社会形象相符合的优质资本市场形象，为中国半导体与集成电路行业的破浪前行树立榜样。

本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前经营情况做出的计划，方案的后续实施会受到行业格局、市场环境、经营决策等各方面因素的影响，存在不确定性。因此方案所涉及的公司业务规划等系非既成事实性的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意相关风险。

华虹半导体有限公司董事会

2025年3月27日